

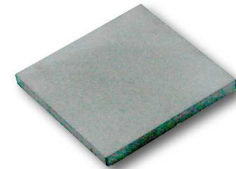
# 片狀 EMI 鐵心 (FP 系列)

## 說明：

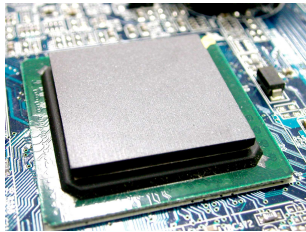
片狀鐵心(FP系列)為薄片狀抑制電磁干擾用鐵心，貼在微處理器上時可抑制由微處理器產生的電磁干擾，貼在兩個微處理器間可預防共振及抑制耦合現象，貼在FFC (軟性扁平排線)或FPC (軟性印刷電路板)上時，可抑制電子設備上經由纜線傳輸的電磁波雜訊，應用在NFC電子錢包(近場通訊)上時，可避免手機電池對讀取距離的影響，貼在無線充電器上的線圈時，可限制發射端及接收端的磁場方向，避免對其他設備產生影響。

## 應用：

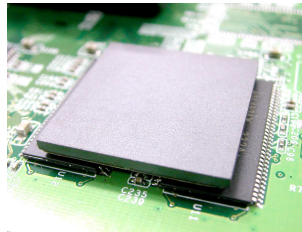
- NFC電子錢包(近場通訊)
- 無線充電器
- 抑制由微處理器產生的電磁干擾
- 預防兩個微處理器間的共振及抑制耦合現象
- 抑制從扁平線傳輸的高頻雜訊以符合FCC、VDE、VCCI及台灣磁檢的要求



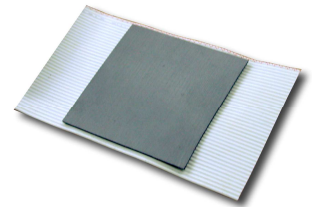
RoHS 2.0  
2011/65/EU



例 1：貼在微處理器上



例 2：置於兩個微處理器間

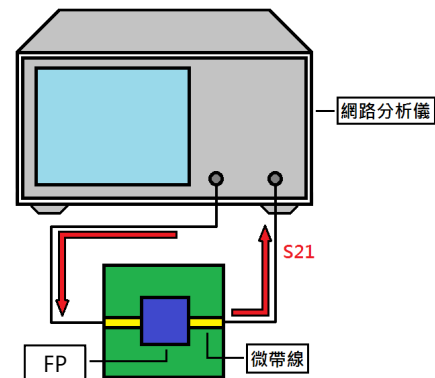
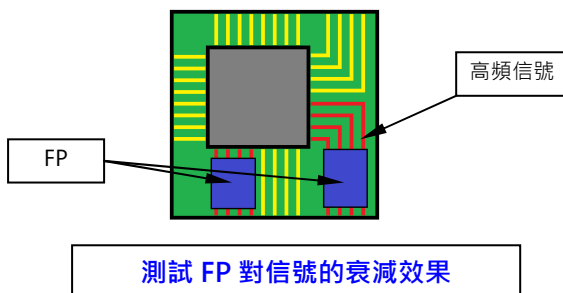


例 3：貼在扁線上

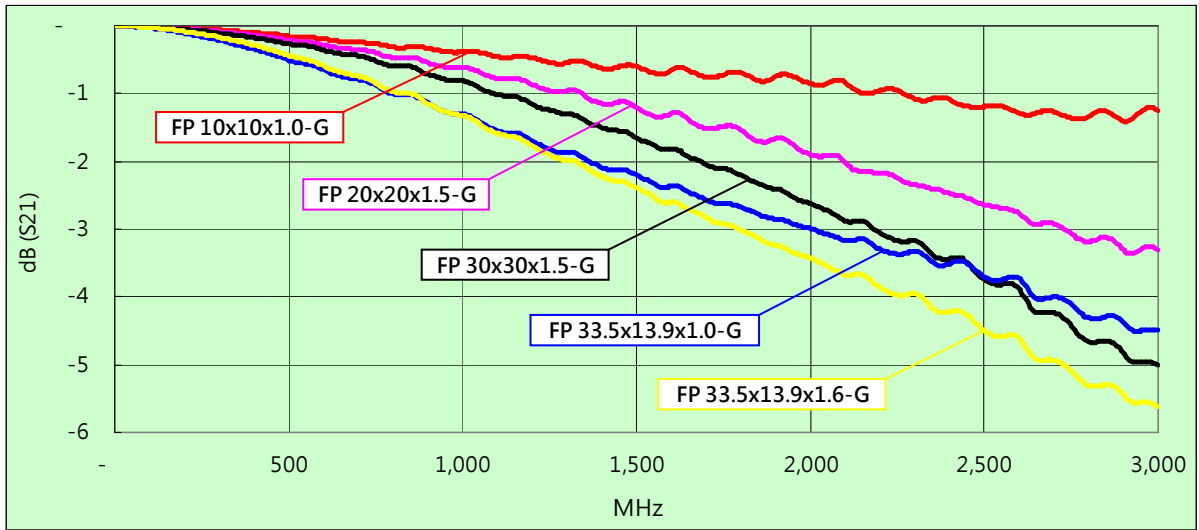
Part Number	長度 (mm)	寬度 (mm)	厚度 (mm)
FP 10 x 10 x 1.0 - G	10	10	1.0
FP 20 x 20 x 1.5 - G	20	20	1.5
FP 30 x 30 x 1.5 - G	30	30	1.5
FP 35.5 x 13.9 x 1.0 - G	35.5	13.9	1.0
FP 35.5 x 13.9 x 1.6 - G	35.5	13.9	1.6

備註：若所需尺寸未在以上列表中，歡迎來信洽詢

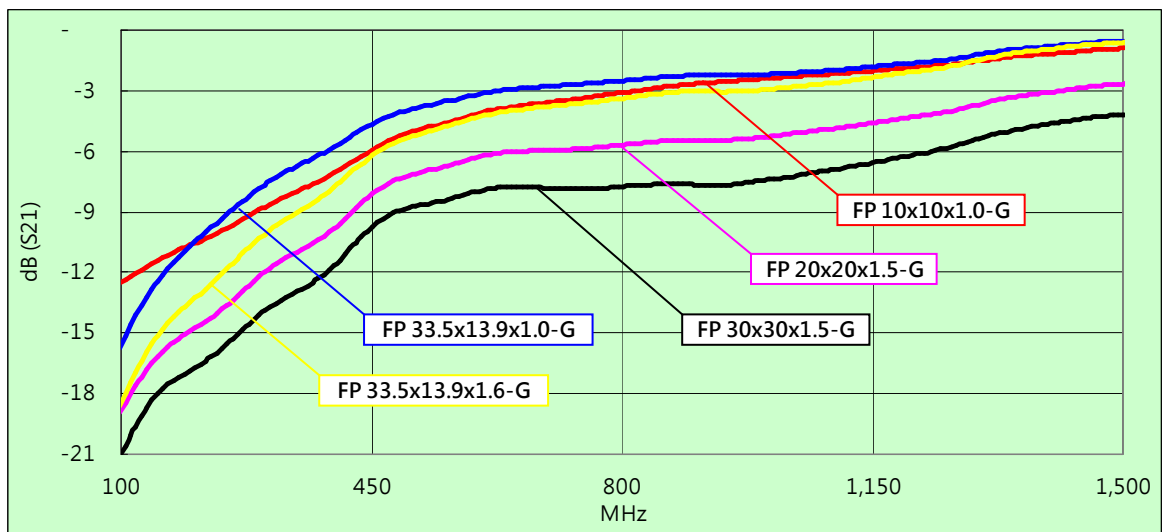
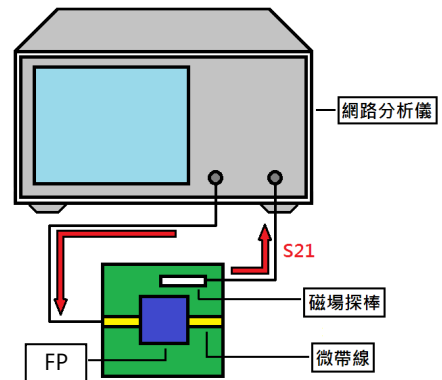
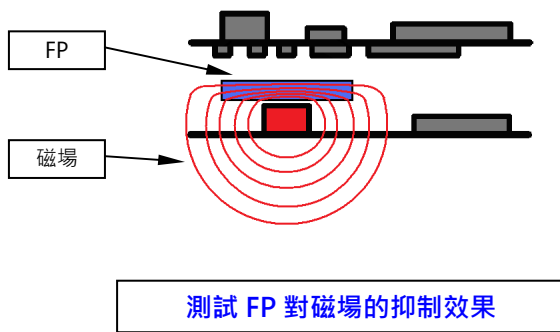
## 濾波效果測試：



# 片狀 EMI 鐵心 (FP 系列)



磁屏蔽/去耦效果測試：



● 以上測值僅供參考，非規格值。